

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ریزپردازنده ۱

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

> انواع ریزپردازندهها و روشهای بستهبندی آنها



سرفصل مطالب این فصل

- انواع ریزپردازندهها
- روشهای بستهبندی تراشه ریزپردازندهها

انواع ريز پردازندهها

- ریزپردازندههای تکتراشه
 - میکروکنترلرها
- ریزپردازندههای RISC و SISC
 - ریزپردازندههای DSP

انواع ريز پردازندهها

ریزپردازنده های تک تراشه:

در این گونه ریزپردازنده ها کلیه اجزاء ریزپردازنده مانند واحد حساب و منطق، واحد کنترل، ثباتها، پرچمها و مدار مولد پالس ساعت در داخل یک تراشه قرار دارند.

میکروکنترلر:

در این گونه ریزپردازندهها علاوه بر واحد پردازش مرکزی، اجزای زیر نیز در آنها قرار دارد:

- انواع حافظههای داده و برنامه
 - شمارنده و تايمرها
- مدارات تبدیل آنالوگ به دیجیتال و بالعکس
 - امكانات كنترل وقفه، مولد موج PWM
 - مدارات ارتباط موازی
- مدارات ارتباط سری از نوع CAN،USB ،I2C ،USART ,SPI
 - ٔ پردازندههای صوت و تصویر



برد آموزشی حاوی میکروکنترلر

انواع ریز پردازندهها



برد آموزشی حاوی میکروکنترلر

انواع ريز پردازندهها

ریزپردازنده های با تعداد دستورالعملهای کاهش یافته:

- استدلال طراحان RISC این است که هیچ کاربری همه دستورات طراحی شده در ریزپردازنده CISC را بکار نمیبرد.
- ریزپردازندههای RISC با تکیه بر کمینه کردن تعداد دستورالعملها گسترش یافتند .
- لذا سعی شد که ضمن کاهش تعداد دستورالعملها، دستورالعملهایی طراحی شوند که ساده و در عین حال پایهای باشند و بتوان به کمک مجموعهای از آنها عملیاتهای پیچیده تر را بخوبی برنامه ریزی و اجرا نمود.
- RISC: Reduced Instruction Set Computer
- CISC: Complex Instruction Set Computer

انواع ریز پردازندهها

ریز پردازندههای ویژه پردازش سیگنال رقمی (DSP)

- پردازندههای سیگنالهای رقمی برای پردازش سیگنالهای دیجیتال طراحی شدهاند و دارای قدرت و سرعت پردازشی بالا میباشند.
- در این پردازندهها، یک سری الگوریتمهای محاسباتی مخصوص پردازش سیگنالها و دادههای رقمی و دستورالعملهای ویژه پردازش سیگنال، بصورت سختافزاری تعبیه شده است.

این نوع ریزپردازندهها در کاربردهایی زیر بکار میروند:

- پردازش تصویر و صوت
- پردازش سیگنالهای راداری
- پردازش سیگنالهای مخابراتی (رادار) و سیگنالهای پزشکی (قلب، مغز، ریه، ماهیچهها)
 - کاربردهای کنترلی
 - و بطور کلی کاربردهایی که در آنها محاسبات زیادی مورد نیاز است

• ریزپردازندهها به دلیل داشتن پایههای داده و آدرس و کنترل به تعداد پین زیادی نیاز دارند.

• اولین بار بستههایی با ۴۰ پایه و از نوع دو ردیفه DIP طراحی شدند. در این نوع بستهبندی، تراشه بصورت یک مستطیل میباشد که پینهای آن بطور موازی از دو طرف خارج شدهاند.



با گسترش امکانات و قابلیت های میکروپروسسورها، نیاز به داشتن پایه های بیشتر در بستهبندیها PGA و PGA ارائه شدند.

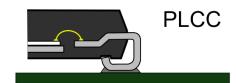
DIP: Dual Inline Package

PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) بسته بندی

• بسته بندی PLCC بدین گونه است که در آن به جای پایههای در دو طرف تراشه، پایهها می توانند در تمام جهات اطراف تراشه قرار داشته باشند.





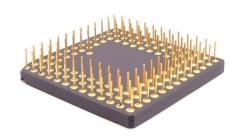


(PGA: Pin Grid Array) بستهبندیهای از نوع

- در بستهبندیهای از نوع PGA، سطح زیر تراشه بصورت یک بستر است که پایهها در آنها قرار میگیرند.
- مشکلی که برای این تراشه مطرح میشود، این است که گرمای حاصله از تراکنشهای داخلی تراشه عملکرد آن را با اشکال مواجه میسازد.
- لذا جنس غالب این بستهبندیها از نوع سرامیک طراحی میشود و تراشه به یک سطح خنککننده بنام هیتسینک متصل میشود تا حرارت تراشه را سریعاً انتقال دهد.
 - علاوه بر تدابیر فوق برای انتقال حرارت تراشه، بر سطح تراشه یک پنکهی کوچک نیز تعبیه میشود.







• بعضی از روشهای بستهبندی تراشهها:

- DIP: Dual Inline Package (also known as PDIP)
- PLCC: Plastic Leaded Chip Carrier
- PGA: Pin Grid Array (also known as PPGA)
- CPGA: Ceramic Pin Grid Array
- <u>FCPGA</u>: Flip-chip Pin Grid Array
- OPGA: Organic Pin Grid Array
- <u>LGA</u>: Land Grid Array
- PQFP: Plastic Quad Flat Pack
- QFN: Quad Flat No Leads
- SOIC: Small-outline Integrated Circuit
- SSOP: Shrink Small-Outline Package
- TQFP: Thin Quad Flat Pack
- TSOP: Thin Small-outline Package



